

LCP 日本宝理 T130 BK005P连接器专用LCP塑胶原料来电洽谈

产品名称	LCP 日本宝理 T130 BK005P连接器专用LCP塑胶原料来电洽谈
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

塑胶原料受热膨胀,热胀系数比金属大很多;

减震效果好 多数塑胶原料富有粘弹性,当它受到机械振动时,塑胶原料内部会产生粘弹内耗,将机械能转变为热能,从而削弱了震动,因此塑料可制作减震消声制品。

日本三井粘结剂QE800E可改善木塑复合材料

一般塑胶原料在常温下和低于其屈服强度的应力下长期受力,会出现形变;

COC具有与PMMA相匹敌的光学性能以及具有高于PC的耐热性,还具有比PMMA和PC更加优良的尺寸稳定性等.COC还具有改善水蒸汽气密性,增加刚性耐热性,易赋予切割性能等优点。

LCP塑胶材料适用于多种间距系列的排母汽车连接器产品的生产上,耐焊接温度在260度-320度之间。这种材料线膨胀系数小,注塑成型收缩率低、强度和弹性模量好、耐热性优良,具有较高的负荷变形温度,还具有优良的耐化学药品和气密性,因此一般连接器尤其需要SMT的都偏爱选择LCP材料。

很不耐酸,不耐强碱和不耐紫外线的辐射。(加入UV剂,能大大提高其耐紫外线等级)

塑胶原料大部分可循环使用,但由于翻用塑料(水口料)比一般原料要脆,所以只可混合新料(原料)一起使用,比例最大不可超过25%为合适,应以顾客要求标准为原则.各种类型的塑料料因所需的熔点不同,所受的注塑压力不同,生产中一定不可相混淆。

POM(又称赛钢、特灵)。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H(聚甲醛均聚物),POM-K(聚甲醛共聚物)是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有的性能。POM属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长,会引起分解。铜是POM降解催化剂,与POM熔体接触的部位应避免使用铜或铜材料。

PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙氧基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件，高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

本公司品种，货源充足，产品原厂原包，，批量采购，原料可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉，诚信的合作”方针；“客户至上，品质为本”是我们的准则；“为客户降低生产成本，”是我们努力的方向。因本公司品种繁多，只能提供部分型号供参考，如需其它型号请来电咨询洽谈！

工程塑料通用塑料的价格虽低廉，但是它的力学性能，耐温、耐蚀性能均难以满足某些工程和设备中用作结构材料的需要，为此工程塑料应运而生，它机械强度高，刚性大，能取代某些钢铁或有色金属材料，可制造结构复杂的机械零件或工程受力件，很多使用效果还超过原来的材料，常用的工程塑料有PA、ABS、PSF、PTFE塑胶原料、POM塑胶原料、PC等。

LCP塑胶原料可以加入高填充剂作为集成电路封装材料，以代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料等。

一般热致性液晶聚合物具有较好的流动性，易加工成型。其成型产品具有液晶聚合物特有的皮芯结构，树脂本身具有纤维性质，在熔融状态下有高度的取向，故可起到纤维增强的效果。这也是液晶聚合物引人注目的特点。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。